# ⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-279991

®Int. Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	<b>③</b> 公開	平成3年(1991)12月11日
G 09 F 3/02 B 32 B 7/02 7/12	105 E	6447-5G 6639-4F 6639-4F		
27/00 33/00	104	7717-4F 7141-4F		
C 09 J 7/02 G 09 F 3/02	JLE F	6770—4 J 6447—5 G		
		審査請求	未請求 氰	青求項の数 3 (全6百)

**公発明の名称** 耐熱性印刷用基材及びラベル

②特 願 平2-80264

**20**出 願 平 2 (1990) 3 月 28日

⑩発 明 者 竹 ノ 下 逸 郎 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内 ⑫発 明 者 富 永 孝 志 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内 ⑫発 明 者 赤 田 祐 三 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電工株式会社内 ⑰出 顋 人 日東電工株式会社 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

他代理人 弁理士藤本 勉

#### 明細

- 1.発明の名称 耐熱性印刷用基材及びラベル
- 2. 特許請求の範囲
  - 1. 無機粉末を有機パイングで保形してなる無機粉末層の片側に硬化型耐熱接着層を少なくとも有してなり、その硬化型耐熱接着層がアクリロニトリル・ブクジエン系共庶合体とノボラック型フェノール樹脂を成分とすることを特徴とする耐熱性印刷用基材。
  - 無機粉末層と硬化型耐熱接着層の間に柔軟な耐熱性基材を有する請求項1に記載の耐熱性印刷用基材。
  - 3. 請求項1に記載の耐熱性印刷用基材における無機粉末層にインクパターンを形成してなることを特徴とするラベル。
- 3 発明の詳細な説明

#### 産業上の利用分野

本発明は、高温下でも接着状態を維持して耐熱性に優れる耐熱性印刷用基材、及びそれを用いたラベルに関する。

### 発明の背景

#### 従来の技術及び課題

従来、前記に応える識別ラベルとして、ポリエステルの如きブラスチックフィルム、ないしその金属蒸着物や紙等からなる基材に、バーインパクトプリンタや熱転写ブリンタ等でパターンを付与したものが提案されている。しかし、基材の耐熱性がブリンタによる加熱温度に耐える程度のものであり、耐熱性に乏しい問題点があった。

# 特開平3-279991(2)

一方、ポリイミドフィルムの裏面にアクリル系 枯着剤窟を有するラベル基材も提案されている。 しかしながら、200℃以下の加熱温度で粘着面が 浮いて被着体より剥離する問題点があった。

### 課題を解決するための手段

本発明は、曲面への固着性、パターンの臨機形成性、及び簡便固着性を満足させつつ、350℃程度の加熱温度にも耐えてその接着状態を維持する高耐熱性の印刷用基材、ないしラベルを開発して前記の課題を克限したものである。

すなわち本発明は、無機粉末を有機パインダで保形してなる無機粉末層の片側に硬化型耐熱接着 層を少なくとも有してなり、その硬化型耐熱接着 層かアクリロニトリル・ブタジエン系共重合体と ノボラック型フェノール制脂を成分とすることを 特徴とする耐熱性印刷用基材、及び

前記の耐熱性印刷用基材における無機粉末層に インクパターンを形成してなることを特徴とする ラベルを提供するものである。

作用

形成する無機粉末層は、2種以上の無機粉末層を重量してなる複層体であってもよい。大変を変化している。一般には、300μmには、300μmには、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、なが、ないの重量が1000重量がある。を対しては、ないのでは、無機粉末層にあり、2000重量の点よりは、無機粉末層にしている。反射率の点よりは、無機粉末層に

### 発明の構成要素の例示

本発明の耐熱性印刷用基材は、第1A図、第1B図、第2図に例示した如く、無機粉末層1の片側に必要に応じ耐熱性基材2を介して硬化型耐熱接着層3を有するものからなる。

おける無機粉末の含有量を30g/i以上とすることが好ましい。

無機粉末層の表面相さ(Ra)は、付与するインクパターンの定着性の向上などの点より0.01~5μm、就中0.05~1.5μmが好ましい。その相さが0.01μm未満では加熱時に、付与したインクパターンが後む場合があり、5μmを超えるとインクパターンの形成時に欠けや抜けの生じる場合がある。

また無機粉末層の表面硬度は、非研磨性の適度 性等の点より鉛筆の硬さに基づきHB~6H、就中H~5Hが好ましい。すなわち、硬度に乏し過ぎると係付きやすい反面、硬度に勝り過ぎると例えば金属等が接触した場合にその金属等が削り取られ、その削り屑が基材に付着してこれがパターン識別時の誤読等の原因となりやすい。

無機粉末層の形成に好ましく用いうる無機粉末としては例えばチタニア、炭化ケイ素、窒化ケイ素、窒化ケイ素、窒化ホウ素、アルミナ、ジルコニア、酸化ケイ素、チタン酸パリウムの如きセラミック粉末、炭酸カルシウム、タルク、CoO-Al2O3、Ni

### 特開平3-279991(3)

O2-CrO3、CoO-MnO2-CrO-Fe2O3、MnO2-Cr2O3の如き類料、アルミニウム粉、ステンレス粉、鉄粉、ニッケル粉、ステンレス粉、鉄粉、ニッケル粉、の如き金属粉末などがあげられる。 就中チクニアが好ましく、特に反射率、クらは、クロリカの類染み性、ないし印字性、クリカのがある。 では、チクニアを30~90重量%用いることが特にない、チクニアを30~90重量%用いることが特に好ましい。用いる無機粉末の粒径は100 mm 以下が適当である。

有機パインダとしては、1種又は2種以上の有機パインダとしては、1種又は2種以上の有機高分子が好ましく用いられる。その例としてはポリイミド、ポリエーテルイミド、ポリエーテルイミド、ポリフェニレンサルファイド、ポリアミドイミド、ポリエステルイミド、芳香族系のポリアミド、パラバン酸樹脂、フッ素樹脂、エポキシ樹脂の如き耐熱性ポリマ、

としては、シランカップリング剤、アルコール変性メラミン樹脂、テトラアルキルチタネートの1種又は2種以上が好ましく用いられる。その使用量は、芳香族ポリアミド100重量部あたり1~35重量部の範囲で、耐熱性や耐熱劣化性、支持基材との接着性などに応じ適宜に決定される。

無機粉末層の片側に、被着体への簡便接着性の付与などを目的として設けられる硬化型耐熱接着層は、アクリロニトリル・ブタジエン系共重合体とノボラック型フェノール樹脂を成分とする接着剤で形成される。

そのアクリロニトリル・ブタジエン系共重合体としては、アクリロニトリル・ブタジエン共動面合体、アクリロニトリルとブタジエンのほかに関係、アクリル酸やそのエステル類、スチレンなどからなみ、ならればからである。アクリロニトリル・ブタジエン共通合体を収置性が小さくて金属やブラスチック等との接着

無機粉末層の形成に際しては、有機パイングの 硬化剤、ないし架機剤のほか、インクパターンの 定着性の向上、支持基材との接着性の向上、途工 液の粘度調節など、種々の目的から適宜な添加 を配合してよい。架機剤の使用は、より腰が強く てへたばりや中折れを起し難く、耐熱性、 耐熱化性に優れる無機粉末層の形成に有効で、 耐熱性基材を介在させない形態の場合に特に和 である。ちなみに、芳香族ポリアミド用の架機剤

ノボラック型フェノール制脂としては、例えばフェノールノボラック、クレソールノボラック、クレソールノボラックの如き一般的なノボラック型のフェノール構脂のほか、ピスフェノールト型やピスフェノールド型、ビスフェノールS型等のノボラック型フェノール制脂、変性キシレン樹脂、その他下記の化合物を成分とするものなどがあげられる。

しい。

前記接着剤に配合することのあるその他の添加 剤としては、カーボン、銀粉、ニッケル粉、アル ミニウム粉の如き導電性、ないし熱伝導性の付与 削、アルミナ粉、シリカ粉、炭化ケイ素粉の如き 絶縁性、ないし熱伝導性の付与剤、チタン系カッ ブリング剤の如き前記粉末等の分散剤、シラン系 やアルミニウム系等のカップリング剤の如き耐水 性向上剤、使用目的等に応じた種々のポリマない し樹脂の如き改質剤、硬化促進剤などがあげられ る。なお硬化促進剤としては例えば、三級アミン 類、イミダソール類、トリフェニルホスフィンの 如き三級リン化合物類、テトラフェニルホスホニ ウムテトラフェニルボレートの如き塩類、ジシア ンジアミド類、トリフェニルホスフィントリフェ ニルボランの如き錯体類、酸無水物類などが用い られる。

硬化型耐熱接着層の形成は例えば、無機粉末層の表面、ないし無機粉末層を設けた耐熱性基材の 表面に、接着剤を塗工する方式や、接着剤からな 耐熱分解性、低吸湿性等の点より好ましく用いうるノボラック型フェノール樹脂は、前記の構造式[1]で表されるものである。 就中、そのヒドロキシル当量が80~250で、nが2~200のものが好ましい。

るシートを予め形成し、これを接着する方式などにより行うことができる。設ける硬化型耐熱接着 層の厚さは5~300μmが一般的であるが、これに 限定されず適宜に決定してよい。硬化型耐熱接着 層の舞出面は、必要に応じ図例の如く、セパレー タ 4 等で被覆保護されて実用に供される。

無機粉末層と硬化型耐熱接着層の間に必要に応じ介在させられる耐熱性基材としては、柔軟で耐熱性、熱寸法安定性の良好なものが用いられる。 就中、150℃以上の耐熱性を有し、熱収縮率が1.5 %以下のものが好ましく用いられる。その例としては、上記の有機パイングとして例示した耐熱性ポリマ等からなるフィルムがあげられる。 献中、ポリイミドフィルムが好ましく用いられる。 耐熱性基材の厚さは適宜に決定してよく、一般には500 m以下、就中10~200 m とされる。

本発明の耐熱性印刷用基材は、耐熱性の印刷用紙として用いることができる。特に、第3図に例示したように、耐熱性印刷用基材を適宜なサイズに成形して識別ラベル等におけるラベル基材6と

## 特開平3-279991(5)

して好ましく用いられる。第3図において、7は ラベル基材6における無機粉末層に、熱転写式の インクリポンとブリンタを用いて形成したインク パターンである。

ラベルの形成は例えば、ラベル形態等とした耐熱性印刷用基材における無機粉末層にパーコード等の所定のインクパターンを付与する方法により行うことができる。また、耐熱性印刷用基材を硬化型耐熱接着層を介し被着体に接着したのち、所定のインクパターンを付与する方法などによっても行うことができる。

被着体に接着された耐熱性印刷用基材、ないし ラベルはそれを加熱処理し、硬化型耐熱接着層を 硬化させて固定処理される。加熱温度はその処理 時間により異なるが、一般には400℃以下、就中、 50~350℃とされる。

無機粉末層へのインクパターンの形成は、転写紙を介しての転写方式、熱転写方式、パーインパクト方式、ドット方式等の各種プリンタを介しての印刷方式、スクリーン印刷方式など、任意な方

シウム30部、タルク20部、粒度平均分子量約3万の(全) 芳香族ポリアミド55部を、N・N・ジメチルアセトアミド195部を用いてロールミルで均一に混練してペーストとし、これをドクターブレード型塗布機にて、剥離剤で処理した厚さ38μmのポリエステルフィルムからなるセパレータの片面にキャスティングし、乾燥させてセパレータ上に厚さ50μmの白色の無機粉末層を形成した。その表面粗さはRa:0.10μmであった。

次に、フェノールノボラック制脂130部(上記構造式 [1]のもの30部を含む)、ピスフェノールA型液状エボキシ樹脂(分子量380)10部、2ーメチルイミグソール1部をメチルエチルケトン35部を用いてロールミルで均一に混練してペーストとし、これをドクターブレード型途布機にて、到離れて処理した厚さ85μmの紙セパレータの研では、動力で処理した厚さ85μmの紙セパレータの硬化型計算を形成し、乾燥させて厚さ20μmの硬化型計算を形成し、それを削記の無機粉末層の開始着して耐熱性印刷用基材を得た。

前記の耐熱性印刷用基材より所定サイズのラベ

式で行ってよい。形成するインクパターンは任意である。なお、耐熱性印刷用基材を形成する場合に、無機粉末と有機パインダの混合物の展開台としてセパレータ等の剥離性支持基材を用いたときには、第1B図の如く、その剥離性支持基材5を無機粉末層1にインクパターンを形成するまでの間、剥がさずに仮着しておいて、パターン形成面を保護しておくことが好ましい。

#### 発明の効果

本発明の耐熱性印刷用基材は、その硬化型耐熱 接着層に基づいて優れた耐熱性を発揮し、350℃ 程度の高温下においても剥かれや浮きを生じず、 被着体との良好な接着状態を安定に持続する。ま た、インクパターンを臨機に付与でき、その柔軟 に基づいて被着体の曲面部に対しても容易、か に基づいて被着することができる。さらに、耐熱性を 材か介在しないタイプの場合には、構造が簡単で 軽量であり、柔軟性、量産性により優れている。

#### 実施例1

チタニア50部(重量部、以下同じ)、炭酸カル

ル基材を切り出し、そのセパレータを剥がして無機粉末層を露出させたのちその面に、パーインパクト式プリンタとインクリポンを介して所定の黒色パーコードパターンを形成してラベルを得、ついで硬化型耐熱接着層用のセパレータを剥がしてこれを厚さ1 mmの鋼板に仮着し300℃で1時間、加熱処理した。

前記により、鋼板に強固に接着したラベルを得た。そのラベルに浮きや剥がれは認められなかった。

#### 実施例2

チタニア60部、炭酸カルシウム20部、タルク20部、粒度平均分子量約3万の(全)芳香族ポリアミド35部をN,N-ジメチルアセトアミド205部を用いてロールミルで均一に混練してペーストとし、これをドクターブレード型塗布機にて厚さ25μmのポリイミドフィルムの片面にキャスティングし、乾燥させて厚さ15μmの白色の無機粉末層を形成した。その表面狙さはRa:0.10μmであった。

次に、アクリル酸含有のニトリル・ブタジエン

# 特開平3-279991(6)

ゴム100郎、クレソールノボラック樹脂60部、ビスフェノールA型液状エポキシ樹脂(分子量380)5部、2ーメチルイミグソール1部を、メチルエチルケトン35部を用いてロールミルで均一に混練してペーストとし、これをドクターブレード型を布機にて、剥離剤で処理した厚さ85μmの紙セで厚めいにキャスティングし、乾燥させて耐能を形成し、それを前記のポリイミドフィルムの露出面に接着して耐熱性印刷用基材を得た。

ついで実施例1に準じ、前記の耐熱性印刷用基 材を用いたラベルを形成し、それを厚さ1 mmのガ ラス・エポキシ基板に仮着下、加熱接着した。

前記により、ガラス・エポキシ基板に強固に接着したラベルを得た。そのラベルに伴きや剥がれは認められなかった。

# 4. 図面の簡単な説明

第1 A 図は耐熱性印刷用基材を例示した断面図、 第1 B 図は前記実施例の他の提供形態を例示した 断面図、第2 図は他の耐熱性印刷用基材を例示し た断面図、第3図はラベルを例示した平面図である。

1:無機粉末層

2:耐熱性蓋材

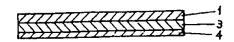
3: 硬化型耐熱接着層

6:ラベル基材

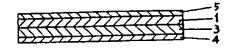
7:インクパターン

特許出願人 日東電工株式会社 代 理 人 藤 本 勉

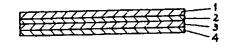
第 1A 図



第 18 図



第 2 図



第3図

